

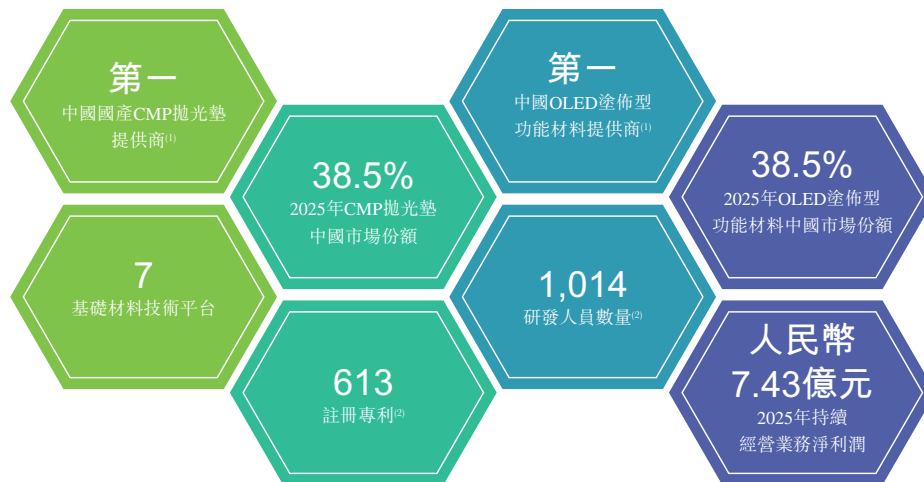
概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概要。由於本文僅屬概要，故並無載列所有閣下可能認為重要的資料。閣下在決定[編纂]前，應細閱整份文件。

任何[編纂]均涉及風險。[編纂]的若干特定風險載於「風險因素」。閣下決定[編纂]前，應細閱該節。

概 覽

我們是中國關鍵行業的材料應用創新領導者。我們為半導體行業提供上游整合的材料及解決方案，包括化學機械拋光（「**CMP**」）解決方案、半導體顯示材料、光刻材料及先進封裝材料。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年的收入計，我們是中國第一大化學機械拋光墊（「**CMP拋光墊**」）國產提供商，市場份額為38.5%，亦是中國第三大**CMP**材料提供商，市場份額為16.8%，以及中國第一大**OLED**塗佈型功能材料提供商，市場份額為38.5%。我們助力客戶實現其供應鏈本土化與技術路線發展，以把握人工智能、先進計算等宏觀趨勢中的機遇。我們也在拓展新能源材料等新興高增長材料市場，並提供打印複印關鍵材料。下圖列示我們的業務核心亮點：



附註：

(1) 按截至2025年12月31日止年度的收入計

(2) 截至2026年4月30日，且僅針對持續經營業務

我們的創新成就

我們的創新成就始終圍繞(i)服務經濟發展的關鍵材料應用行業；(ii)上游整合的材料、生產、應用、評價體系；(iii)自主創新的研發及知識產權創造；及(iv)內部人才的培養。我們對自主創新的執著追求，推動了我們成功的業務轉型，以及客戶供應鏈的本土化。

- 2012年：我們實現彩色聚合碳粉（「**CPT**」）的商業化生產。
- 2016年：**CMP**拋光墊項目一期投產。
- 2020年：年產1,000噸柔性顯示用黃色聚醯亞胺（「**YPI**」）產業化項目投產。

概 要

- 2021年：化學機械拋光液（「**CMP拋光液**」）及CMP後清洗液（「**清洗液**」）生產線一期投產，且柔性顯示用光敏聚醯亞胺（「**PSPI**」）生產線一期建成。
- 2023年：半導體先進封裝材料（即封裝聚醯亞胺（「**封裝PI**」）和臨時鍵合膠（「**TBA**」）項目投產。
- 2024年：位於潛江的高端晶圓光刻膠（即氟化氫（「**ArF**」）和氟化氬（「**KrF**」）光刻膠）生產線一期工程完工。
- 2026年：位於潛江的ArF和KrF光刻膠生產線二期投產。

我們的業務

我們提供半導體材料及解決方案，以滿足客戶優化供應鏈，並推進下一代產品及技術研發的需求。我們的半導體材料及解決方案包括：(i)CMP解決方案；(ii)半導體顯示材料；及(iii)先進半導體材料及其他。我們亦提供打印複印關鍵材料，如CPT。此外，我們正拓展新興高增長材料應用，例如新能源行業的鋰電池功能性輔材。

下表載列我們來自持續經營業務的主要產品之詳情：

業務	產品	用途	客戶類型
半導體材料及解決方案—CMP解決方案	CMP拋光墊、CMP拋光液和清洗液	集成電路製造中的CMP工藝核心耗材	集成器件製造商（「 IDMs 」）、晶圓代工廠
半導體材料及解決方案—半導體顯示材料	YPI、PSPI及薄膜封裝墨水（「 TFE-INK 」）	OLED顯示面板製造用的關鍵主材	顯示面板廠
半導體材料及解決方案—先進半導體材料及其他	KrF及ArF浸沒式（「 ArFi 」）光刻膠	集成電路製造中的光刻工藝關鍵材料	IDMs、晶圓代工廠
	封裝PI及TBA	半導體先進封裝環節的關鍵材料	外包半導體封測廠、晶圓廠
	集成電路芯片	打印複印通用耗材用芯片	打印複印通用耗材終端硒鼓、墨盒生產商
打印複印關鍵材料	CPT	打印複印通用耗材用CPT	打印複印通用耗材終端硒鼓生產商
新能源材料及其他	鋰電池分散劑及黏結劑	鋰電池關鍵功能工藝性輔材	動力電池及儲能電池企業

概 要

於往績記錄期間，我們也經營硒鼓業務及墨盒業務，產品涵蓋激光打印機用硒鼓及噴墨打印機用墨盒。於2026年4月，我們完成對珠海名圖及績迅科技的處置，該兩家公司系本集團的組成部分，並代表獨立主要業務。根據國際財務報告準則，上述兩家公司的相關經營業務已於往績記錄期間列報為已終止經營業務。

我們與客戶的協作

我們的半導體材料及解決方案客戶主要包括IDMs、晶圓代工廠及顯示面板製造商。我們致力於滿足客戶對先進半導體材料安全穩定供應的需求，並通過體系化的研發能力以及與行業領先客戶的協作，推動半導體製造的技術進步。我們與半導體客戶建立緊密的合作夥伴關係，攜手客戶聯合設計產品，推動快速迭代，實現其技術路線圖。我們在材料科學領域積累了深厚且廣博的知識，能夠通過供應精準匹配的半導體材料，提供以客戶為中心的解決方案。此外，通過對皓飛新材的戰略性收購，我們得以服務全球領先的新能源客戶。我們的打印複印關鍵材料客戶主要為終端市場產品製造商(例如硒鼓及墨盒製造商)。

我們的材料技術平台

經過多年持續的自主研發與產品創新，我們將自身技術與專長提煉整合為七大材料技術平台，包括：

- 有機合成技術平台
- 高分子合成技術平台
- 物理化學技術平台
- 無機非金屬材料技術平台
- 微球合成發泡技術平台
- 工程裝備設計技術平台
- 材料應用評價技術平台

這七大平台為全價值鏈提供基礎技術支撐，覆蓋從原材料至終端產品的所有環節，包括生產設備、製造工藝、質量檢測及應用驗證。七大平台的協同和發展驅動持續的產品創新及性能提升，促進在全新前沿領域取得突破。

我們的機遇

人工智能正深刻改變材料應用領域，其通過驅動研發範式向數據與智能化方法的轉型，顯著加速了材料創新週期，並刺激了半導體、新能源等關鍵領域對高性能材料的市場需求。

我們認為半導體材料領域存在重大機遇與強勁需求，其驅動力源於(i)全球半導體供應鏈再平衡及對關鍵材料供應的需求；(ii)人工智能發展帶動半導體芯片的強勁需求；及(iii)先進封裝與新型芯片架構的發展。根據弗若斯特沙利文的資料，預計2026年至2030年，中國CMP材料市場將以16.1%的複合年增長率從人民幣97億元增長至人民幣176億元；中國OLED塗佈型功能材料市場將以10.8%的複合年增長率從人民幣15億元增長至人民幣23億元；中國半導體晶圓光刻膠市場將以11.1%的複合年增長率從人民幣86億元增長至人民幣131億元；中國半導體先進封裝材料市場將以12.0%的複合年增長率從人民幣232億元增長至人民幣365億元。

概 要

我們也正積極把握新能源材料市場的強勁增長機遇。其增長得益於新能源汽車、大型儲能、AI數據中心、低空經濟及機器人等領域的材料變革性應用。根據弗若斯特沙利文的資料，中國鋰電池功能性輔材行業市場預計從2026年的人民幣352億元增長至2030年的人民幣630億元，複合年增長率為15.7%。

我們的財務表現

於往績記錄期間，我們的經營業績實現顯著增長。於2023年、2024年及2025年，以及截至2025年及2026年4月30日止四個月，我們的持續經營收入分別為人民幣1,305.3百萬元、人民幣1,953.4百萬元、人民幣2,467.6百萬元、人民幣723.8百萬元及人民幣1,090.3百萬元。其中，我們的半導體材料及解決方案收入在我們整體收入中的佔比分別為73.4%、81.8%、86.5%、85.6%及78.5%。此外，於2023年、2024年及2025年，以及截至2025年及2026年4月30日止四個月，我們持續經營業務的淨利潤率分別為17.6%、27.5%、30.1%、29.0%及32.3%。

研發

我們已建立一套覆蓋基礎研究、產品開發、工藝優化及應用驗證的系統化研發及成果轉化體系。我們的核心研發樞紐湖北鼎龍先進材料創新研究院引領前沿技術創新。截至2026年4月30日，我們的研發團隊共有1,014名技術人員，佔總人數的三分之一以上。於往績記錄期間，我們研發投入總額達人民幣14億元，佔持續經營總收入的20.5%。

生產

我們以位於中國的四大生產基地為支點建立一體化、智能化、敏捷化的生產體系。我們的核心優勢在於覆蓋從原材料合成至成品的全流程自主產能，依託專線運營與嚴苛的質量管控體系。為確保卓越的產品性能，公司採用源自知名供應商的定製化核心設備包括澆注機、反應釜等。這不僅保障了高合格率與品質一致性，更通過定製化開發與快速交付，靈活響應客戶的多元化需求。公司運營效率由全面的智能工廠架構所驅動。通過分佈式控制系統與生產執行系統，公司實現了投料、混合、過濾等關鍵工藝的自動化，相較半自動化產線，效率提升30%以上。於往績記錄期間，公司未發生任何重大生產中斷事故。

原材料及供應商

我們戰略性地構建了針對預聚體、緩衝墊及特種樹脂等關鍵原材料的自主生產能力；此類材料對產品性能至關重要、成本佔比較高且國內供應稀缺。這一上游垂直整合有效保障了產品品質、供應鏈穩定性與成本效益，夯實了公司的市場競爭力，並契合供應鏈本土化趨勢。於往績記錄期間，我們主要從多元化供應商處採購基礎化學品(如雙氧水、有機溶劑)及非關鍵原材料。

於往績記錄期間，我們持續經營業務向前五大供應商的採購總額分別為2023年的人民幣93.0百萬元、2024年的人民幣146.2百萬元、2025年的人民幣174.7百萬元及截至2026年4月30日止四個月的人民幣107.8百萬元，分別佔相應年度／期間總採購額的20.1%、20.8%、21.0%及30.6%。

概 要

銷售及客戶

我們採用直銷模式。我們的成功源於對客戶的深入了解與穩定的生產品質。我們將客戶獨特的工藝需求轉化為定製化材料及綜合解決方案。我們的客戶主要為IDMs、晶圓代工廠以及顯示面板製造商等。於往績記錄期間，我們持續經營業務來自每一年度／期間前五大客戶的收入分別為2023年的人民幣554.5百萬元、2024年的人民幣1,041.7百萬元、2025年的人民幣1,316.2百萬元及截至2026年4月30日止四個月的人民幣567.1百萬元，分別佔相應年度／期間總收入的42.5%、53.4%、53.5%及52.1%。

競爭優勢

我們認為，以下競爭優勢為我們取得成功作出了貢獻，並使我們有別於競爭對手：

- 中國領先的半導體材料及解決方案提供商；
- 服務關鍵市場的全面產品組合；
- 與行業龍頭客戶的深度合作；
- 從核心原材料開始的自主全流程技術；
- 根植於體系化研發能力的材料科學與工程製造專長；及
- 遠見卓識的管理團隊，具有經實證的創新能力。

增長戰略

我們計劃實施以下策略，以進一步鞏固我們的市場地位：

- 依託我們的技術平台，推動跨行業發展；
- 聚力端到端自主研發，鍛造核心競爭壁壘；
- 完善人才體系，深化客戶協同合作；及
- 拓展全球經營版圖，把握長期增長動力。

競爭

在我們的主要業務中，我們的競爭對手包括境內外供應商，涵蓋CMP材料、OLED塗佈型功能材料、高端晶圓光刻膠及彩色聚合碳粉等產品的供應商。我們參與的競爭主要基於產品性能及可靠性、技術能力、客戶服務及響應速度、供應鏈安全以及價格等因素。我們相信，憑藉全面的產品組合、從核心原材料開始的端到端自主研發及生產能力、與行業領先半導體製造商之間深厚的客戶關係，以及半導體材料行業較高的進入壁壘，我們能夠進行有效競爭。

歷史及財務資料概要

下表呈列的綜合財務數據概要應與本文件附錄一所載之會計師報告(包括相關附註)一併閱讀，並應受其整體所規限。

概 要

綜合損益及其他全面收益表概要

下表載列我們於所示年度／期間的綜合損益及其他全面收益表概要：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%
	(未經審計)									
持續經營業務：										
收入	1,305,336	100.0	1,953,405	100.0	2,467,551	100.0	723,811	100.0	1,090,304	100.0
銷售成本	(560,104)	(42.9)	(688,456)	(35.2)	(822,638)	(33.3)	(254,239)	(35.1)	(367,861)	(33.7)
毛利	745,232	57.1	1,264,949	64.8	1,644,913	66.7	469,572	64.9	722,443	66.3
銷售及營銷開支	(53,500)	(4.1)	(70,576)	(3.6)	(76,281)	(3.1)	(25,751)	(3.6)	(38,487)	(3.5)
一般及行政開支	(149,060)	(11.4)	(230,068)	(11.8)	(255,919)	(10.4)	(80,929)	(11.2)	(99,697)	(9.1)
研發開支	(328,139)	(25.1)	(402,733)	(20.6)	(475,607)	(19.3)	(145,217)	(20.1)	(190,283)	(17.5)
以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產公允價值收益／ (虧損)	6,900	0.5	9,847	0.5	(9,044)	(0.4)	58	0.0	(7)	(0.0)
金融資產減值虧損淨額	(10,521)	(0.8)	(18,372)	(0.9)	(2,711)	(0.1)	(1)	(0.0)	(760)	(0.1)
於聯營公司投資的減值虧損	(20,757)	(1.6)	(18,785)	(1.0)	(18,857)	(0.8)	—	—	—	—
其他收入	91,004	7.0	78,022	4.0	80,540	3.3	18,055	2.5	22,272	2.0
其他(虧損)／收益淨額	(7,105)	(0.5)	12,766	0.7	(2,308)	(0.1)	3,069	0.4	5,535	0.5
融資成本	(16,386)	(1.3)	(24,168)	(1.2)	(51,811)	(2.1)	(8,489)	(1.2)	(15,030)	(1.4)
分佔聯營公司及合營 企業業績	2,210	0.2	7,829	0.4	20,320	0.8	1,940	0.3	3,023	0.3
除稅前利潤	259,878	19.9	608,711	31.2	853,235	34.6	232,307	32.1	409,009	37.5
所得稅開支	(30,236)	(2.3)	(71,782)	(3.7)	(109,880)	(4.5)	(22,680)	(3.1)	(56,436)	(5.2)
持續經營業務的 年度／期間利潤	229,642	17.6	536,929	27.5	743,355	30.1	209,627	29.0	352,573	32.3
已終止經營業務 已終止經營業務的 年度／期間利潤／(虧損)	58,111	4.5	101,869	5.2	52,276	2.1	28,046	3.9	(1,034)	(0.1)
年度／期間利潤	287,753	22.0	638,798	32.7	795,631	32.2	237,673	32.8	351,539	32.2

概 要

收入

下表載列於所示年度／期間我們的持續經營業務收入明細，以絕對金額及佔持續經營業務總收入百分比列示：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣		人民幣		人民幣		人民幣		人民幣	
	千元	%	千元	%	千元	%	千元	%	千元	%
(未經審計)										
持續經營業務：										
半導體材料及解決方案	957,981	73.4	1,598,433	81.8	2,135,125	86.5	619,656	85.6	855,483	78.5
—化學機械拋光解決方案	494,644	37.9	931,154	47.7	1,385,191	56.1	374,954	51.8	614,264	56.3
—半導體顯示材料	173,900	13.3	401,919	20.6	544,490	22.1	174,071	24.0	176,253	16.2
—先進半導體材料及其他	289,437	22.2	265,360	13.6	205,444	8.3	70,631	9.8	64,966	6.0
打印複印關鍵材料	313,955	24.0	319,386	16.4	314,105	12.8	95,090	13.1	110,485	10.1
新能源材料及其他	33,400	2.6	35,586	1.8	18,321	0.7	9,065	1.3	124,336	11.4
總計	1,305,336	100.0	1,953,405	100.0	2,467,551	100.0	723,811	100.0	1,090,304	100.0

毛利及毛利率

我們的毛利等於持續經營業務收入減持續經營業務銷售成本。我們的毛利率指毛利佔持續經營業務收入的百分比。下表載列於所示年度／期間我們按業務分部劃分的毛利及毛利率：

	截至12月31日止年度						截至4月30日止四個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣		人民幣		人民幣		人民幣		人民幣	
(未經審計)										
持續經營業務：										
半導體材料及解決方案	599,350	62.6	1,098,894	68.7	1,486,906	69.6	418,994	67.6	613,739	71.7
打印複印關鍵材料	133,285	42.5	160,178	50.2	152,375	48.5	48,627	51.0	60,256	54.5
新能源材料及其他	12,597	37.7	5,877	16.5	5,632	30.7	1,951	21.5	48,448	39.0
總額	745,232	57.1	1,264,949	64.8	1,644,913	66.7	469,572	64.9	722,443	66.3

概 要

綜合財務狀況表概要

下表載列我們於所示日期的我們的綜合財務狀況表概要：

	截至12月31日			截至4月30日
	2023年	2024年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審計)
流動資產總額	2,827,255	2,943,703	3,815,008	3,543,028
非流動資產總額	3,880,644	4,451,058	5,250,585	5,911,516
總資產	6,707,899	7,394,761	9,065,593	9,454,544
流動負債總額	936,448	1,457,376	1,204,590	1,462,086
非流動負債總額	895,516	1,062,875	2,346,027	2,395,603
總負債	1,831,964	2,520,251	3,550,617	3,857,689
流動資產淨值	1,890,807	1,486,327	2,610,418	2,080,942
淨資產	4,875,935	4,874,510	5,514,976	5,596,855

截至2023年12月31日及2024年12月31日，我們的淨資產保持相對穩定，分別為人民幣4,875.9百萬元及人民幣4,874.5百萬元，主要由於年度利潤人民幣638.8百萬元，惟大幅被附屬公司所有權權益變動(主要涉及收購非全資附屬公司的少數股東權益)人民幣528.1百萬元及股份回購人民幣150.0百萬元所抵銷。截至2025年12月31日，我們的淨資產增至人民幣5,515.0百萬元，主要由於年度利潤人民幣795.6百萬元及行使購股權人民幣172.1百萬元，惟部分被附屬公司所有權權益變動(主要涉及收購非全資附屬公司的少數股東權益)人民幣286.7百萬元及已付股息人民幣120.2百萬元所抵銷。截至2026年4月30日，我們的淨資產進一步增至人民幣5,596.9百萬元，主要由於期間利潤人民幣351.5百萬元及收購附屬公司產生的非控股權益增加人民幣107.4百萬元，惟部分被附屬公司所有權權益變動(主要涉及收購非全資附屬公司的少數股東權益)人民幣162.2百萬元、處置已終止經營業務人民幣143.0百萬元及已宣派股息人民幣94.7百萬元所抵銷。

我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣1,890.8百萬元減少至截至2024年12月31日的人民幣1,486.3百萬元，主要由於流動負債增加人民幣520.9百萬元，主要包括(i)借款增加人民幣346.1百萬元；及(ii)其他應付款項及應計費用增加人民幣144.2百萬元；部分被流動資產增加人民幣116.4百萬元所抵銷，主要由於貿易應收款項及應收票據增加人民幣154.9百萬元導致。

我們的流動資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣1,486.3百萬元增加至截至2025年12月31日的人民幣2,610.4百萬元，主要由於流動資產增加人民幣871.3百萬元，主要包括(i)現金及現金等價物增加人民幣517.5百萬元；(ii)其他投資(包括衍生工具)增加人民幣131.9百萬元；及(iii)預付款項、其他應收款項及其他資產增加人民幣123.4百萬元。

我們的流動資產淨值由截至2025年12月31日的人民幣2,610.4百萬元減少至截至2026年4月30日的人民幣2,080.9百萬元，主要由於流動資產減少人民幣272.0百萬元，主要包括(i)現金及現金等價物減少人民幣272.1百萬元；及(ii)其他投資(包括衍生工具)減少人民幣66.2百萬元，惟部分被預付款項、其他應收款項及其他資產增加人民幣168.4百萬元所抵銷；連同我們的流動負債增加人民幣257.5百萬元，主要由於其他應付款項及應計費用增加人民幣271.2百萬元。

概 要

綜合現金流量表

下表載列於所示年度／期間我們的綜合現金流量表摘要：

	截至12月31日止年度			截至4月30日 止四個月	
	2023年 人民幣千元	2024年 人民幣千元	2025年 人民幣千元	2025年 人民幣千元 (未經審計)	2026年 人民幣千元
經營活動所得現金淨額	427,446	639,230	1,028,456	263,216	388,810
投資活動所用現金淨額	(1,020,268)	(581,297)	(1,102,873)	(358,691)	(802,804)
融資活動所得／(所用)現金淨額	661,558	(133,802)	593,092	1,062,038	138,928
現金及現金等價物 增加／(減少)淨額	68,736	(75,869)	518,675	966,563	(275,066)
年初／期初的現金及現金等價物	1,033,710	1,101,530	1,025,582	1,025,582	1,543,032
年末／期末的現金及現金等價物	1,101,530	1,025,582	1,543,032	1,992,319	1,270,924

主要財務比率

下表載列截至所示日期或於所示年度／期間的主要財務比率：

	截至12月31日／截至該日的年度			截至 4月30日／ 截至該日的 四個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
毛利率 ⁽¹⁾	57.1%	64.8%	66.7%	66.3%
淨利率 ⁽²⁾	17.6%	27.5%	30.1%	32.3%
流動比率 ⁽³⁾	3.0	2.0	3.2	2.4

附註：

- (1) 毛利率按相關年度／期間持續經營業務的毛利除以持續經營業務的收入計算。
- (2) 淨利率按相關年度／期間持續經營業務的利潤除以持續經營業務的收入計算。
- (3) 流動比率按截至相關日期的流動資產除以流動負債計算。

股息

於2025年7月10日，我們宣派歸屬於2024年12月31日止年度應佔末期股息人民幣94.5百萬元，並已於2025年7月17日支付。此外，於2026年6月10日，我們宣派歸屬於2025年12月31日止年度應佔末期股息人民幣95.3百萬元，並已於2026年6月17日支付。截至最後實際可行日期，所有已宣派的末期股息均已悉數派付。

[編纂]完成後，我們可能以現金或我們的公司章程允許的其他方式分派股息。未來是否宣派或支付股息及股息金額將由董事會酌情決定，並將取決於多項因素，包括我們的經營業績、現金流量、財務狀況、附屬公司向我們支付現金股息、業務前景、有關宣派及支付股息的法定及監管限制，以及董事會可能認為重要的其他因素。任何股息宣派、支付及金額均受憲章文件及相關法律規限。股東可批准任何股息宣派。

概 要

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及其他估計[編纂]開支後，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即[編纂])，我們估計將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]港元。我們擬將[編纂]按下文所載用途及金額使用，惟可因應我們不斷演變的業務需求及市況變化而作出調整：(i)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於推進我們的全球戰略擴張及我們的提升全球影響力；(ii)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們半導體材料及其他先進材料(尤其是高端晶圓光刻膠)的持續技術研發及產品迭代，以保持我們的市場領先地位；(iii)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於戰略投資及收購，以實施我們的長期增長戰略；(iv)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們核心業務的產能擴充及產業化項目；(v)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於擴大我們的銷售網絡及支持市場推廣活動，旨在提升我們產品的市場覆蓋率及品牌影響力；及(vi)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於營運資金及一般企業用途。有關詳情，請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」。

[編纂]開支

我們應承擔的[編纂]開支估計約為[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂])，約佔[編纂]估計[編纂]的[編纂]%，假設概無根據[編纂]發行任何股份。[編纂]開支包括(i)[編纂]相關開支(包括[編纂]佣金)約[編纂]港元；及(ii)非[編纂]相關開支約[編纂]港元，包括(a)我們法律顧問及申報會計師的費用及開支約[編纂]港元；及(b)其他費用及開支約[編纂]港元。於往績記錄期間，計入綜合損益表的[編纂]開支為人民幣1.1百萬元(1.2百萬元)。於往績記錄期間後，預計約[編纂]港元將計入我們的綜合損益表，約[編纂]港元將於[編纂]時自權益扣除。我們認為上述費用或開支對本集團而言並非重大或異常高昂。上述[編纂]開支僅為最後實際可行估計，實際金額可能有別於該估計。

風險因素

我們的營運及[編纂]涉及若干風險及不確定因素，包括但不限於：

- 我們於競爭激烈的行業中營運，倘我們未能成功競爭，我們的業務、經營業績及前景或會受損；
- 我們的業績取決於採用我們產品的下游行業之需求，而該等行業增長放緩可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 倘我們未能及時且具有成本效益地開發並商業化符合客戶偏好並獲市場接納的新產品，我們的業務、財務狀況及經營業績或會受到不利影響；
- 我們的質量控制體系未必能完全避免產品瑕疵或不合格情況；及
- 倘我們無法按時大規模生產或交付高質量產品，我們的業務或會受到重大不利影響。

概 要

[編纂]

下表中的所有統計數字乃基於假設(i)[編纂]已完成，而[編纂]股H股於[編纂]中發行及出售；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)[編纂]完成後，已發行及發行在外的股份為[編纂]股。

	按[編纂] 每股H股 [編纂]港元 計算	按[編纂] 每股H股 [編纂]港元 計算
A股的市值 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
於[編纂]完成後H股的[編纂]	[編纂]	[編纂]
計及A股及H股的[編纂]總額	[編纂]	[編纂]
本集團未經審計[編纂]經調整每股 [編纂]資產[編纂] ⁽²⁾	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 根據緊接最後實際可行日期前五個營業日A股平均收市價每股A股人民幣93.98元(按人民幣0.8692元兌1.00港元計算為108.12港元)及截至最後實際可行日期總股本953,198,181股A股計算。
- (2) 未經審計[編纂]經調整綜合每股[編纂]資產[編纂]乃經作出本文件「附錄二 — 未經審計[編纂]財務資料」一節所述的調整後計算得出。

一致行動協議及我們的單一最大股東集團

根據彼等於2007年11月訂立的一致行動協議，朱雙全先生和朱順全先生構成本公司單一最大股東集團。截至最後實際可行日期，彼等合共可行使約[29.09]%本公司已發行股本總額所附投票權；於[編纂]完成後(假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後實際可行日期起及直至[編纂]本公司已發行股本總額並無其他變動，且不包括因可換股債券獲轉換而可能發行的任何A股)，彼等將可行使約[編纂]%本公司已發行股本總額所附投票權。

有關詳情，請參閱「歷史及公司架構 — 一致行動協議及單一最大股東集團」及「與我們單一最大股東集團的關係」。

購股權激勵計劃

我們已採納2024年購股權激勵計劃。截至最後實際可行日期，根據2024年購股權激勵計劃已授出的未行使購股權數目為9,280,611股，約佔緊隨[編纂]完成後(假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後實際可行日期起及直至[編纂]本公司已發行股本總額並無其他變動，且不包括因可換股債券獲轉換而可能發行的任何A股)已發行股份的[編纂]%。倘所有該等未行使購股權獲悉數行使，假設[編纂]未獲行使，以及自最後實際可行日期起至[編纂]日期止期間本公司已發行股本並無其他變動，則股東於[編纂]後緊隨持有的已發行及發行在外股份將被攤薄約[編纂]%。有關詳情，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — D. 2024年購股權激勵計劃」。

我們於深圳證券交易所上市

於2010年2月，我們於深圳證券交易所完成A股上市(股票代碼：300054)。有關詳情，請參閱「歷史及公司架構 — 公司發展及主要股權變動」。

概 要

重大收購及出售

於2026年2月，本公司收購皓飛新材的70%股權。該等收購為本公司戰略性進軍新能源材料行業，特別是鋰電池功能性輔材(例如黏結劑及分散劑)領域。

於2026年4月，本公司出售珠海名圖的60%股權及績迅科技的15%股權，以進一步聚焦半導體材料核心業務，優化整體業務組合併提升資源配置效率。由於出售事項，珠海名圖及績迅科技的營運於往績記錄期間分類為已終止經營業務。完成出售事項後，珠海名圖及績迅科技成為本集團的聯營公司。

有關詳情，請參閱「歷史及公司架構—重大收購、出售及合併」。

近期發展

2026年5月，我們的CMP拋光液業務取得進一步進展。具體而言，若干類型的CMP拋光液產品，例如大硅片精拋液、氧化銻拋光液、TSV拋光液及SiC襯底拋光液產品，取得客戶訂單，且若干核心CMP拋光液產品獲得一家國內頭部邏輯芯片代工客戶認可。

2026年6月，我們公佈擬在潛江生產基地建設第三條CMP拋光軟墊生產線，重點生產玻璃基板CMP拋光墊及大尺寸CMP拋光墊。該項目規劃年產能為300,000片，計劃投資金額為人民幣30.0百萬元。

2026年6月，我們亦在高端晶圓光刻膠商業化方面繼續取得進展。在我們年產300噸的生產線於2026年3月投產後，我們向兩家國內頭部晶圓廠客戶交付ArFi及KrF光刻膠，該等客戶其後新增訂單。截至最後實際可行日期，本集團八款高端晶圓光刻膠產品已取得多家國內主流晶圓廠客戶的批量訂單。此外，我們已佈局超過40款高端晶圓光刻膠產品，其中近30款進入客戶驗證階段。

2026年6月，就2025年宣派的現金股息已全數派付。

無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，自2026年4月30日以來，我們的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動。